



■ Liebe iMAPS-Mitglieder,

das Jahr 2015 stand für uns alle voll und ganz im Zeichen der EMPC 2015, die Mitte September in Friedrichshafen stattfand. Der Beginn der Planung für die Konferenz erfolgte bereits im Herbst 2012, als mich unser ehemaliger 1. Vorsitzender Heinz Osterwinter darauf hinwies, dass – sollte ich mich 2013 zum 3. Mal zum 1. Vorsitzenden wählen lassen – ich doch bitteschön auch als General Chair der EMPC in 2015 aktiv werden möge. Ich nahm diese Aufgabe gerne an, wohlwissend, dass ich ein exzellentes ‚Orga-Team‘ hinter mir haben würde.

An dieser Stelle mein besonderer Dank an Technical Chair Dr. Markus Detert, der das Paper Management und Review organisierte und so den herausragenden wissenschaftlichen Standard der über einhundert Vor-

träge und Poster gewährleistete. General Co-Chair Ernst Eggelaar hielt bei der Messenvorbereitung die Fäden in der Hand und koordinierte alle Vorbereitungen vor Ort in Friedrichshafen. Unser Technical Co-Chair, Prof. Jens Müller, übernahm neben seinen Review-Aufgaben die komplette Organisation von zwei Sessions im Rahmen des iKersaTec-Projekts. Martina Creutzfeldt und ihre Kolleginnen von der mcc Agentur für Kommunikation GmbH sorgten für den reibungslosen Ablauf der Veranstaltung und gaben der EMPC 2015 ihr prägnantes Erscheinungsbild. Viele Kolleginnen und Kollegen aus dem In- und Ausland unterstützten uns beim Abstract Review.

Auch ihnen allen sei herzlich gedankt. Wir freuen uns sehr über das durchweg positive Feedback der über 300 Teilnehmer und fast 50 Aussteller. Viele lobten





neben der hohen Qualität der Vorträge vor allem die gute Organisation und die charmante Ausstrahlung des Veranstaltungsorts. Wo sonst tritt man aus der Messe vor die Tür und hat den Blick über Bodensee und Alpenpanorama?

Ein absolutes Highlight war die Drei-Länder-Bootstour mit Gala-Dinner auf dem Bodensee, die wohl allen Beteiligten noch lange in Erinnerung bleiben wird.

Aus den Vorträgen und Posterbeiträgen wurden ein ‚Best Paper‘ und ein ‚Best Poster‘ ausgewählt, die jeweils in der Abschluss-session ausgezeichnet wur-

den. Unser Glückwunsch geht an Andreas Ostmann (IZM) für den Best Paper Award und an Sophie Engelsberger (Hochschule Landshut) für den Best Poster Award.

An dieser Stelle möchte ich gerne noch einmal unseren leider viel zu früh verstorbenen 1. Vorsitzenden Heinz Osterwinter würdigen. Er hatte mit der letzten „deutschen“ EMPC 2003 in Friedrichshafen Maßstäbe gesetzt und sich in der Frühphase der Planung für 2015 wieder sehr für Friedrichshafen als Veranstaltungsort stark gemacht. Der Erfolg hat ihm Recht gegeben.

iMAPS intern

Unsere sonst jährlich stattfindende nationale Herbst-Konferenz fiel zwar aufgrund der EMPC 2015 aus, nicht aber unsere Mitgliederversammlung, die wir am 1. Konferenzabend der EMPC in Friedrichshafen abhielten. Hier gab es dann auch eine Änderung im Vorstand, da unser bisheriger Schriftführer Dr. Ruben Perrone aus beruflichen Gründen nicht mehr neu kandidierte. Seine Aufgaben übernimmt ab jetzt Dirk Schade von der XYZTec GmbH, der einstimmig zum neuen Schriftführer gewählt wurde. Herzlichen Dank an dieser Stelle an Ruben Perrone, der weiterhin im erweiterten Vorstand aktiv bleiben wird.

Zum Schluss wie immer noch ein kleiner Ausblick auf die Veranstaltungen des kommenden Jahres. Wir sind auch 2016 wieder Partner der 8. DVS/GMM-Fachtagung Elektronische Baugruppen und Leiterplatten EBL 2016 – Multifunktionale Baugruppen – Leistungsdichten am Limit? in Fellbach, die von DVS und GMM gemeinsam organisiert und am



16./17.02.2016 stattfinden wird. Die nächste IMAPS Herbstkonferenz ist geplant für den 20./21.10.2016 an der Hochschule München.

Ferner wurden bereits in Friedrichshafen die Weichen für ein Frühjahrseminar in Erlangen am FAPS gestellt.

Im Namen des gesamten Vorstandes möchte ich abschließend allen IMAPS-Mitgliedern und ihren Familien auch für das Jahr 2016 beste Gesundheit und alles nur erdenklich Gute wünschen. Lasst uns unser Netzwerk erweitern und neue Mitglieder anwerben. Bitte unterstützen Sie uns alle auch weiterhin tatkräftig dabei und bei der Vereinsarbeit sowie beim aktiven Erfahrungsaustausch, der uns doch allen zu Gute kommt.

Herzlichst,



Martin Schneider-Ramelow
1. Vorsitzender IMAPS-Deutschland



■ **Das Cluster Mechatronik & Automation möchte Sie über das erste Clustersymposium zum Thema**

„User Interfaces – Technologien, Komponenten, Fertigung und Test“ am 16.-17. Februar 2016 an der TH Ingolstadt

informieren. Das Symposium bietet den Teilnehmern an 2 Tagen kompaktes Know-how über Benutzerinterfaces in der Industrie. Schwerpunktbranchen sind die industrielle Automation, der Bereich Health-Care aber auch die Automobilindustrie als Vorreiter. Die Spannweite reicht dabei von Komponenten wie Displays, Tasten, Wippen, Drehstellern oder Leiterplatten über Technologien wie LEDs, Displays (OLED, TFT), Force Sense, Force Feedback (mechan. Anregung z. B. Piezotechnologie), Akustik, Touch,

Multitouch und Gestenerkennung (3D-Scan) über Neue Materialien, Kalibrierung und Forschung wie Glas, Smart Materials, Qualifizierungsmethoden für haptische Bedienelemente, Bonding, Kalibrierung und Justage bis hin zu Testsystemen für Labor und Fertigung (Drahtlose Systemtechnologie, Produktflexible Testsysteme, Lichttechnik, Bildverarbeitung, Haptik, Prüfstandsarchitekturen, Robotik, Motion, Beleuchtungstechnologien, Messtechnik und Kommunikationstechnik). Ziel des Symposiums ist es, das Thema User Interfaces ganzheitlich aus Sicht von Anwendern und Anbietern aus unterschiedlichen Branchen zu diskutieren, Trends zu erkennen, gängige Marktlösungen zu entdecken um diese im eigenen Unternehmen umzusetzen.

Weitere Infos erhalten Sie unter www.cluster-ma.de

■ Veranstaltungskalender

Ort	Zeitraum	Name	Veranstalter
Edinburgh	17. März 2016	MicroTech 2016	IMAPS UK
Erlangen	14. April 2016	Frühjahrsseminar	IMAPS D, FAPS
Denver	19.-21. April 2016	CICMT	IMAPS US, ACeRS
Albuquerque	10.-12. Mai 2016	HiTEC 2016	IMAPS US
Grenoble	13.-16. Sept. 2016	ESTC	IEEE, IMAPS EU
München	20./21. Okt. 2016	Herbstkonferenz	IMAPS D

■ Die Proceedings

Die Proceedings des Seminars zum Thema „Volumenintegration – Stapeln, Falten, Vergraben“ in Dresden und der Konferenz in München 2014 können auf CD zum Preis von € 55,- erworben werden.



Die aktuelle CD-ROM enthält neben den Vorjahresproceedings auch die mehrerer früherer Herbst- und Frühjahrsveranstaltungen. Unsere Seminare sind traditionell themenorientiert und beschäftigen sich zuvor mit zu Themen wie „Medizintechnik – Herausforderungen an das Packaging“, „Manche mögen's heiß – Power Electronic Packaging“, oder „Ist Zuverlässigkeit noch bezahlbar?“

Ihre Bestellungen richten Sie bitte an:

Ernst Eggelaar, c/o Microtronic GmbH,
Kleingrötzing, D-84494 Neumarkt-St.Veit,
Fax +49-8722-9620-30, ee@microtronic.de

Bitte beachten Sie, dass der angegebene Preis gemäß §4 Nr.22 UStG umsatzsteuerfrei ist und die verfügbare Anzahl begrenzt ist.

■ IMAPS Deutschland – Ihre Vereinigung für Aufbau- und Verbindungstechnik

IMAPS Deutschland, Teil der „International Microelectronics and Packaging Society“ (IMAPS), stellt seit 1973 in Deutschland das Forum für alle dar, die sich mit Mikroelektronik und Aufbau- und Verbindungstechnik beschäftigen. Mit mehr als 300 Mitgliedern verfolgen wir im Wesentlichen drei wichtige Ziele:

- wir verbinden Wissenschaft und Praxis
- wir sorgen für den Informationsaustausch unter unseren Mitgliedern und
- wir vertreten den Standpunkt unserer Mitglieder in internationalen Gremien.

■ Impressum

IMAPS Deutschland e. V.: 1. Vorsitzender:
Prof. Dr.-Ing. Martin Schneider-Ramelow
Fraunhofer-Institut für Zuverlässigkeit
und Mikrointegration (IZM)

Head of Dep.: System Integration
and Interconnection Technologies

Gustav-Meyer-Allee 25, 13355 Berlin
Tel +49 30 46403-172 (-270 Sekr., Fax -271)

martin.schneider-ramelow@izm.fraunhofer.de
www.izm.fraunhofer.de, Schatzmeister

(bei Fragen zu Mitgliedschaft und Beitrag):
Ernst G. M. Eggelaar, ee@microtronic.de



Ausführliche Kontaktinformationen
zu den Vorstandsmitgliedern
finden Sie unter www.imaps.de
(Vorstand)